



Panasonic Electronic Materials Division launches a new product brand for the Semiconductor Device Materials business. The IC substrate materials' brand is transitioning from MEGTRON GX to LEXCM GX. パナソニック 電子材料事業部は、新たに半導体デバイス材料の製品ブランドを LEXCM (レクシム) としてスタートします。それに伴い、半導体パッケージ基板材料は MEGTRON GX から LEXCM GX へ変更いたします。

Low stress Low CTE Ultra-thin IC substrate materials

低応力・低熱膨張・極薄対応半導体パッケージ基板材料

LEXCMGX

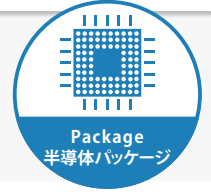
Laminate R-G525T (Low CTE glass cloth) R-G525F (Normal glass cloth)

Prepreg R-G520T (Low CTE glass cloth) R-G520F (Normal glass cloth)

Applications 用途

IC substrate

半導体パッケージ基板



Realize low warpage at several types of IC package by low stress property.

応力を緩和し、様々な半導体パッケージ構成においても低反りを実現

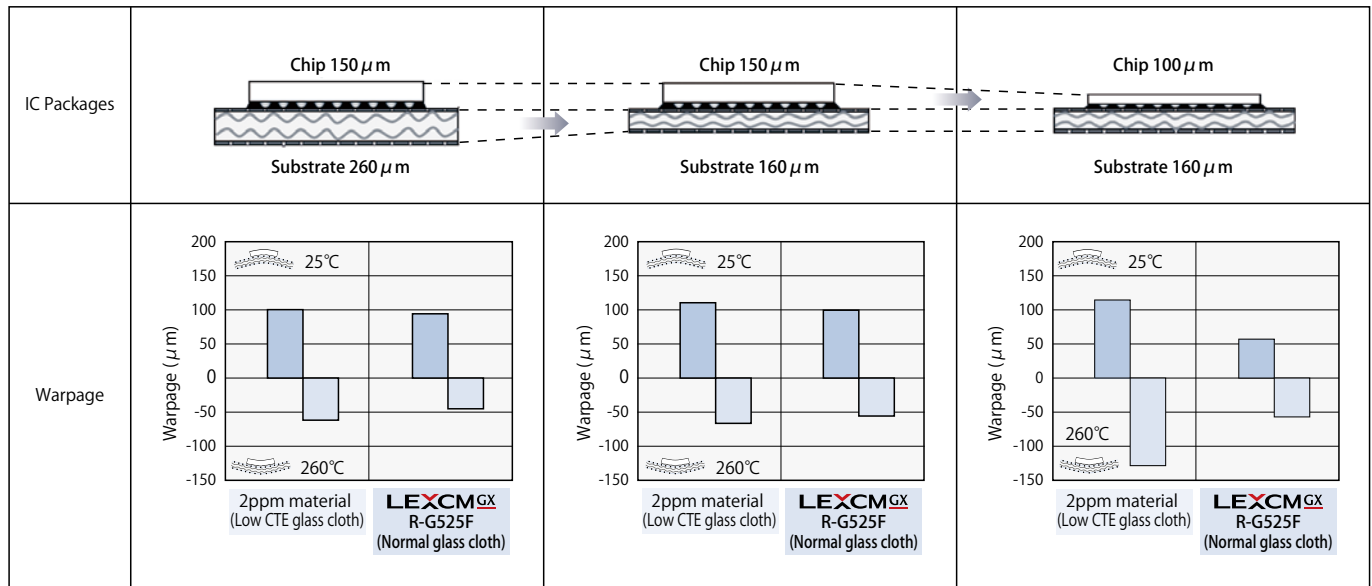
Low Stress

CTE x, y-axis
3-5ppm/°C

Tg (DMA)
270°C

IC package warpage

半導体パッケージ基板 反り評価



General properties 一般特性

Item	Test method	Condition	Unit	LEXCMGX R-G525T Low CTE glass cloth	LEXCMGX R-G525F Normal glass cloth	
				Glass transition temp.(Tg)	DMA ^{*2}	A
Thermal decomposition temp.(Td)	TGA	A	°C	365	365	
CTE x-axis	α 1	Internal method	A	ppm/°C	3-5	5-7
CTE y-axis					3-5	5-7
Flexural modulus ^{*1}	Warp	JIS C 6481	25°C	GPa	20	17
	Fill				19	16

The sample thickness is 0.1 mm.

*1 0.8mm *2 Measurement in tensile mode

Our Halogen-free materials are based on JPCA-ES-01-2003 standard and others. 当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003などの定義によるものです。The above data are typical values and not guaranteed values. 上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

Please see the page for "Notes before you use" [商品のご採用に当たっての注意事項](#) [こちら](#)